

芯联集成电路制造股份有限公司

关于公司控股子公司向银行申请项目贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“芯联先锋”）拟向银行申请不超过人民币 70 亿元的项目贷款。
- 该事项无需提交公司股东大会审议

一、公司控股子公司申请项目贷款情况概述

根据芯联先锋与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》的相关内容，计划三期 12 英寸中试项目的基础上，实施量产项目，预计在未来两到三年内合计形成投资 222 亿元人民币、10 万片/月产能规模的中芯绍兴三期 12 英寸数模混合集成电路芯片制造项目。具体内容详见《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于公司子公司与绍兴滨海新区管委会签订〈落户协议〉的公告》（公告编号：2023-005）。

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》，同意公司新增募投项目“中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》（公告编号：2023-007）。

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第

十一次会议，审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》，拟实施“三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目”（以下简称“本项目”）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》（公告编号：2024-001）

为保证本项目的顺利实施，根据目前项目的建设计划，芯联先锋拟将以本项目不超过价值人民币 70 亿元的设备作为抵押物向银行申请总额不超过人民币 70 亿元的项目贷款。具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签订的协议为准。芯联先锋将授权其总经理签署借款合同及其他相关文件。

二、审议程序

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款的议案》，同意公司控股子公司将以本项目不超过价值人民币 70 亿元的设备作为抵押物向银行申请不超过人民币 70 亿的项目贷款的事项。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日